附件：

会议审定、预审、讨论和任务落实的标准项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组别 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 |
|  | 第  一  组 | 国标委发[2021]23号20213238-T-469 | 碳化硅晶体材料缺陷图谱 | 广东天域半导体科技有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2021]23号20213239-T-469 | 蓝宝石图形化衬底片 | 广东中图半导体科技股份有限公司 | 审定 |
|  | 工信厅科函[2022]94号  2022-0082T-YS | 高纯铟 | 云南锡业集团控股有限责任公司 | 预审 |
|  | 工信厅科函[2022]94号  2022-0083T-YS | 高纯铟化学分析方法 第 1部分：痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科函[2022]94号  2022-0084T-YS | 红外及激光材料用硒化氢 | 广东先导稀材股份有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科函[2023]18号  2023-0082T-YS | 半导体材料掺杂用扩散膜 | 安徽安芯电子科技股份有限公司 | 任务落实 |
|  | 第  二  组 | 工信厅科函[2021]291号  2021-1758T-YS | 二氧化碳排放核算与报告要求 多晶硅企业 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2021]41号20214647-T-469 | 半导体晶片近边缘几何形态评价 第1部分：高度径向二阶导数法（ZDD） | 山东有研半导体材料有限公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2022]17号20220133-T-469 | 埋层硅外延片 | 南京国盛电子有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科函[2022]312号  2022-2014T-YS | 再生硅料 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2022]94号  2022-0108T-YS | 改良西门子法多晶硅用硅芯 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科函[2022]94号  2022-0081T-YS | 多晶硅还原炉用氮化硅制品 | 新疆晶硕新材料有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科函[2022]94号  2022-0110T-YS | 硅片包装和标志 | 浙江海纳半导体有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科函[2022]94号  2022-0111T-YS | 晶片包装片盒表面颗粒的测试 液体颗粒计数法 | 麦斯克电子材料股份有限公司 | 预审 |
|  | 工信厅科函[2023]18号  2023-0001T-YS | 集成电路用四甲基硅烷 | 洛阳中硅高科技有限公司 | 任务落实 |
|  | 工信厅科函[2023]18号  2023-0083T-YS | 区熔用多晶硅材料 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 任务落实 |